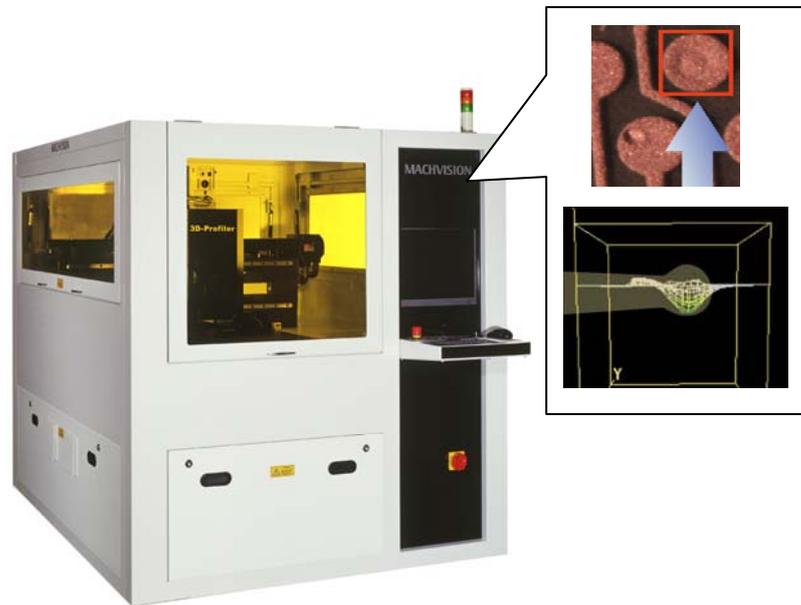


# 3D Profiler™

ビアメッキ表面窪み検査装置



## Specification

Model	3DP-3000
機械構造	花崗岩ベース
本体寸法	2080 × 2000 × 2030mm (L × W × H)
本体重量	2600kg
作業エリア	550mm × 650mm (オプション: 660 × 810 mm)
ビア径	60 ~ 150μm
窪み深さ	30μm
最大アスペクト比	1 : 3 (深さ : 径)
最大ビア数	> 1000k
SPC アナライザー	3DViewer™
操作システム	Windows™ family
電源	AC220V; 3P; 60Hz; 7.6KW; Max. 30A

\* 規格内容は予告なく変更されることがあります。